



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20080821000A

2009 年 7 月 24 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

営業・技術本部 カスタマドキュメント

マネージャ 牧 達郎 (牧)

IS0723x/4x製品 MSL変更 取消のご案内

(初版 PCN20080821000 2008 年 9 月 3 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	☒ Others	☒ Packing/Shipping/Labeling		☒ MSL
変更内容	初版連絡の下記変更内容についての取消の連絡になります。 ISO723x/4x 製品 パッケージ MSL 変更 現行　：パッケージ MSL： MSL-3 変更後：パッケージ MSL： MSL-2			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	-			
品質認定試験	☐ 計画		☐ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☐ 変更あり	
備考	-			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、2008年9月3日発行 初版 PCN20080821000 にて連絡しました下記変更について、変更取消の連絡になります。対象製品のパッケージ吸湿耐熱性は、現行 MSL-3 に変更ありません。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。

今回のお知らせは、通知のみを目的としたものになります。

弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) IS0723x/4x製品について、対象製品のパッケージ吸湿耐熱性 MSLの評価確認を基に、MSL-3からMSL-2への変更を認定いたしました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容
吸湿耐熱性

現行
MSL-3

変更後
MSL-2

理由：MSL適正表示の為

対象製品リスト

対象製品名				
IS07230ADW	IS07231ADWR	IS07240CDW	IS07240MDWRG4	IS07242ADWG4
IS07230ADWG4	IS07231ADWRG4	IS07240CDWG4	IS07241ADW	IS07242ADWR
IS07230ADWR	IS07231CDW	IS07240CDWR	IS07241ADWG4	IS07242ADWRG4
IS07230ADWRG4	IS07231CDWG4	IS07240CDWRG4	IS07241ADWR	IS07242CDW
IS07230CDW	IS07231CDWR	IS07240CF	IS07241ADWRG4	IS07242CDWG4
IS07230CDWG4	IS07231CDWRG4	IS07240CFDW	IS07241CDW	IS07242CDWR
IS07230CDWR	IS07231MDW	IS07240CFDWG4	IS07241CDWG4	IS07242CDWRG4
IS07230CDWRG4	IS07231MDWG4	IS07240CFDWR	IS07241CDWR	IS07242MDW
IS07230MDW	IS07231MDWR	IS07240CFDWRG4	IS07241CDWRG4	IS07242MDWG4
IS07230MDWG4	IS07231MDWRG4	IS07240DDW	IS07241MDW	IS07242MDWR
IS07230MDWR	IS07240ADW	IS07240DDWR	IS07241MDWG4	IS07242MDWRG4
IS07230MDWRG4	IS07240ADWG4	IS07240MDW	IS07241MDWR	
IS07231ADW	IS07240ADWR	IS07240MDWG4	IS07241MDWRG4	
IS07231ADWG4	IS07240ADWRG4	IS07240MDWR	IS07242ADW	

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルのMSLがMSL 2に変更されます。

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 2 月 8 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	ISO7240CFDW	Die Name:	ALB7240CFLAAC/ ABLF7240CFRAAC	
Die Size(mils):	32x114/ 49x114	Wafer Fab Site:	DFAB / DFAB	
Fab Process:	LBC4/ LBC4 (BOAC)	Die OverCoat:	None/ BCB	
Package / Pins:	DW / 16	Assembly Site:	TITL (TAI)	
Mold Compound:	LOC GR825-73B	Mount Compound:	HIT EN4088Z	
Bond Wire:	TS - 1.3mils	Leadframe / Finish:	Cu / NiPdAu	
Moisture Sensitivity Level:	Level 2-260C			
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Autoclave	121C , 240 Hours		80/0	
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles		97/0	
**Temp Cycle	-65/+150C, 1000 Cycles		75/0	
ESD	CDM: 1500V		3/0	
Latch-Up	@ 70C		6/0	
Electrical Characterization	Per spec		Approved	
Solderability	8 Hrs Steam Age		22/0	
Lead Fatigue	Per mfg spec		22/0	
Lead Pull	Per mfg spec		22/0	
Bond Strength	Per mfg spec (Wires)		76/0	
Die Shear	Per mfg spec		5/0	
X-Ray	Per mfg spec		5/0	
Manufacturability Qualification (Wafer Fab)	Per site spec		Approved	
Manufacturability Qualification (Assembly)	Per site spec		Approved	
Moisture Sensitivity	L2/260C		12/0	
Certification	UL-1577		Approved	
** Preconditioning sequence: JEDEC Level 2-260C				
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	ISO7240CFDW	Die Name:	ALB7240CFLAAC/ ABLF7240CFRAAC	
Die Size(mils):	32x114/ 49x114	Wafer Fab Site:	DFAB / DFAB	
Fab Process:	LBC4/ LBC4 (BOAC)	Die OverCoat:	None/ BCB	
Package / Pins:	DW / 16	Assembly Site:	HANA (HNT)	
Mold Compound:	SUM EME-G600	Bond Wire:	TS-1.25 Au	
Leadframe / Finish:	Cu / NiPdAu	Moisture Sensitivity Level:	Level 2-260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
ESD	HBM: 4000V		12/0	
	MM: 200V		3/0	
Electrical Characterization	Per spec		Approved	
Preconditioning Information: ** Preconditioning sequence: N/A				